

# ノーシアン高速無電解銅めっき液

Cyanide-free, High-speed Electroless Copper Plating Solution

## OPCカッパー NCA

OPC COPPER NCA

- **高い析出速度**

Great deposition performance

- **浴中のホルムアルデヒド濃度を低減**

Decrease formaldehyde concentration in bath

- **ファインパターン性に優れる**

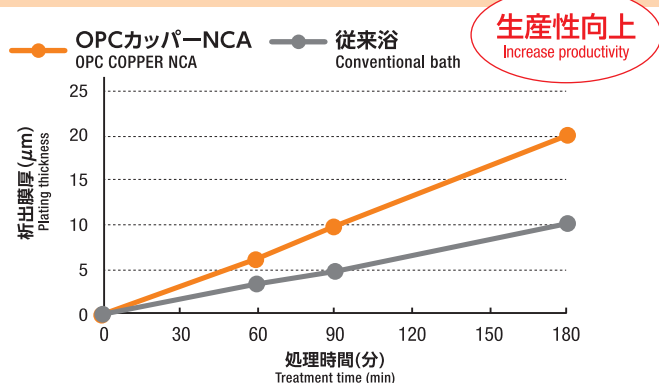
Excellent in fine pattern ability

- **浴安定性に優れる**

Excellent bath stability

### 高い析出速度 6 $\mu$ m/h

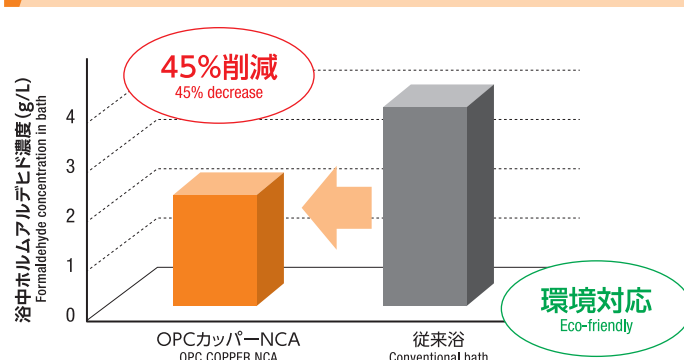
Great deposition performance



OPCカッパー-NCAの処理時間当たりの析出膜厚  
Deposition speed of OPC COPPER NCA

### 低いホルムアルデヒド濃度

Low formaldehyde concentration



ホルムアルデヒド濃度の比較  
Comparison of formaldehyde concentration

# 無電解めっき用シード層ペースト

Paste to Form Seed Layer for Electroless Plating

## トップALP CP-1958

TOP ALP CP-1958

- **熱硬化型ペースト**

Thermo-setting paste

- **基板およびめっき皮膜との密着性に優れる**

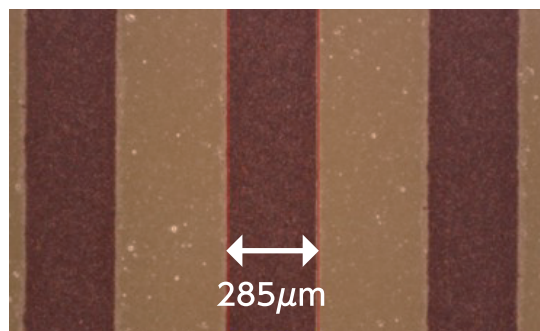
Great adhesion performance between substrate and plated film

- **パターン性に優れる**

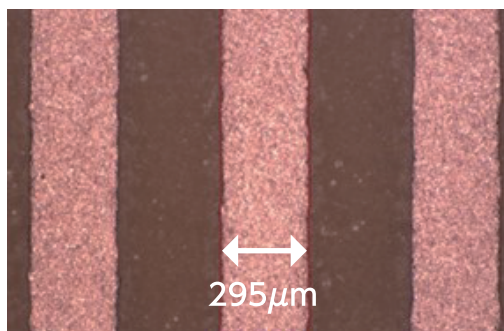
Excellent in pattern forming performance

### ファインパターン性に優れる

Excellent in fine pattern ability



めっき用シード層のパターン  
After forming seed layer for plating



無電解銅めっき後のパターン  
After electroless copper plating

パターン形成条件  
Pattern forming condition

- スクリーン印刷  
Screen printing  
(ステンレス500メッシュ)  
Stainless mesh (500)

L/S=300 $\mu$ m/300 $\mu$ m